

深圳丹邦科技股份有限公司

关于微电子级 PI 膜产品通过科技成果鉴定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市科技创新委员会授权，2017 年 1 月 13 日深圳市高新技术产业协会主持了深圳丹邦科技股份有限公司及其全资子公司广东丹邦科技有限公司联合研制的“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目科技成果鉴定会，鉴定委员会成员听取了该项目的研制技术总结报告，审查了检测报告、查新报告等技术资料，并查看了相关技术产品样品，进行了质询，经认真讨论，形成鉴定意见如下：

1、相关资料齐全，符合鉴定要求。

2、丹邦科技研制的高性能聚酰亚胺薄膜，通过对聚酰亚胺分子结构优化设计，引入官能团，提高了产品性能；开发了聚酰胺酸（PAA）的低温化学酰亚胺化工艺；发展了喷涂-双向拉伸法生产超薄聚酰亚胺薄膜技术，提高了薄膜平整性和力学性能。该项成果经客户试用，预计将产生良好的经济效益与社会效益、具备产业推广应用条件。

3、产品主要性能通过通标标准技术服务有限公司、深圳市华测检测技术股份有限公司、惠州市安普检测技术服务有限公司等第三方检测单位的检测，聚酰亚胺薄膜厚度最薄 6 微米，介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平。

综上所述，鉴定委员会成员认为本项目开发的聚酰亚胺薄膜综合性能达到国际先进水平，填补国内空白，建议尽早实现该成果的产业化生产，为我国微电子行业的发展做出更大的贡献，一致同意通过科技成果鉴定。

目前公司尚未收到鉴定证书，待收到正式证书后另行公告。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017年1月13日